

2022-2028年中国芯片封测 行业前景展望与市场供需预测报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2022-2028年中国芯片封测行业前景展望与市场供需预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202201/261588.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

芯片封装测试，球形触点陈列，表面贴装型封装之一。

5G技术商用带来的SiP封装需求增量。首先由于单机射频价值提升，射频前端整体市场规模快速增长。而射频前端模组化，5G毫米波天线、射频集成化是大势所趋，由于射频元件大多使用GaAs为基底材料，而5G天线多使用LCP(LiquidCrystalPolymer)为材料等，而SiP封装能很好地满足异质整合的需求。预计SiP封装在射频市场的采用率将迅速提高。

5G毫米波推动对AiP解决方案的需求。毫米波工作频段高，波长短，所以要求天线具有更小的体积；而高频高损耗的特性要求在5G手机中引入更多数量的天线，导致AiP

(AntennainPackage，天线封装)技术，将天线与芯片集成在封装里，成为理想的解决方案，很好地兼顾了天线性能、成本以及体积。

2025年，AiP的SiP封装需求有望超过400亿元人民币。2025年全球5G手机出货量有望达到12亿只，假设其中大陆地区5G手机中支持毫米波机型比例为50%，海外地区5G手机中支持毫米波占比达到75%；假设2025年支持5G毫米波手机中，AiP方案的渗透率为65%，则到2025年，预计采用AiP方案的手机出货量将达到5.3亿只，AiP的SiP封装需求市场规模约为440亿元。全

球AiP的SiP封装需求测算 中企顾问网发布的《2022-2028年中国芯片封测行业前景展望与市场供需预测报告》共十二章。首先介绍了中国芯片封测行业市场发展环境、芯片封测整体运行态势等，接着分析了中国芯片封测行业市场运行的现状，然后介绍了芯片封测市场竞争格局。随后，报告对芯片封测做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国芯片封测行业发展趋势与投资预测。您若想对芯片封测产业有个系统的了解或者想投资中国芯片封测行业，本报告是您不可或缺的重要工具。 本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。报告目录：第一章 芯片封测行业相关概述1.1 半导体的定义和分类1.1.1 半导体的定义1.1.2 半导体的分类1.1.3 半导体的应用1.2 半导体产业链分析1.2.1 半导体产业链结构1.2.2 半导体产业链流程1.2.3 半导体产业链转移1.3 芯片封测相关介绍1.3.1 芯片封测概念界定1.3.2 芯片封装基本介绍1.3.3 芯片测试基本原理1.3.4 芯片测试主要分类1.3.5 芯片封测受益的逻辑 第二章 2015-2019年国际芯片封测所属行业发展状况及经验借鉴2.1 全球芯片封测所属行业发展分析 SiP封装产业链参与者向上下游延伸是趋势。传统SiP封装产业链上，IC封测的代表公司有长电科技、日月光，主要提供功能级的标准封测产品；系统级封装的代表公司是环旭电子，主要做模组级别的系统封装；两者属于上下游关系，涉及到的制程和设备有所区别。而EMS/OEM组装的代表公司有立讯精密、歌尔股份等。各个环节参与者更多是各司其职、互相合作。而随着电子加工技术发展和品牌厂

商缩短供应链条长度、加强供应商管理的需求增强，每个环节参与者以自身技术为基础，向上下游延伸成为了产业趋势。以封测厂为例，星科金朋具备IC封测和系统级封装能力；而环旭电子以SiP封装为基础，日月光的IC封测跟公司在模组的系统封装上实现协同，同时通过收购加快往下游延伸，提升EMS业务占比；而下游组装厂商如立讯精密，以自身SMT技术为基础，积极布局SiP封装，试图切入系统级封装环节。

2018年全球前十封测厂营收

2.1.1 全球半导体市场发展现状

2.1.2 全球封测市场竞争格局

2.1.3 全球封装技术演进方向

2.1.4 全球封测产业驱动力分析

2.2 日本芯片封测行业发展分析

2.2.1 半导体市场发展现状

2.2.2 半导体市场发展规模

2.2.3 芯片封测企业发展状况

2.2.4 芯片封测发展经验借鉴

2.3 中国台湾芯片封测行业发展分析

2.3.1 芯片封测市场规模分析

2.3.2 芯片封测企业盈利状况

2.3.3 芯片封装技术研发进展

2.3.4 芯片封测发展经验借鉴

2.4 其他国家芯片封测行业发展分析

2.4.1 美国

2.4.2 韩国

第三章 2015-2019年中国芯片封测行业发展环境分析

3.1 政策环境

3.1.1 智能制造发展战略

3.1.2 集成电路相关政策

3.1.3 中国制造支持政策

3.1.4 智能传感器行动指南

3.1.5 产业投资基金支持

3.2 经济环境

3.2.1 宏观经济发展现状

3.2.2 工业经济运行状况

3.2.3 经济转型升级态势

3.2.4 未来经济发展展望

3.3 社会环境

3.3.1 互联网运行状况

3.3.2 可穿戴设备普及

3.3.3 研发经费投入增长

3.3.4 科技人才队伍壮大

3.4 产业环境

3.4.1 集成电路产业链

3.4.2 产业销售规模

3.4.3 产品产量规模

3.4.4 区域分布情况

3.4.5 设备发展状况

第四章 2015-2019年中国芯片封测行业发展全面分析

4.1 中国芯片封测行业发展综述

4.1.1 行业主管部门

4.1.2 行业发展特征

4.1.3 行业生命周期

4.1.4 主要上下游行业

4.1.5 制约因素分析

4.1.6 行业利润空间

4.2 2015-2019年中国芯片封测所属行业运行状况

4.2.1 市场规模分析

4.2.2 主要产品分析

4.2.3 企业类型分析

4.2.4 企业市场份额

4.2.5 区域分布占比

4.3 中国芯片封测行业技术分析

4.3.1 技术发展阶段

4.3.2 行业技术水平

4.3.3 产品技术特点

4.4 中国芯片封测行业竞争状况分析

4.4.1 行业重要地位

4.4.2 国内市场优势

4.4.3 核心竞争要素

4.4.4 行业竞争格局

4.4.5 竞争力提升策略

4.5 中国芯片封测行业协同创新发展模式分析

4.5.1 华进模式

4.5.2 中芯长电模式

4.5.3 协同设计模式

4.5.4 联合体模式

4.5.5 产学研用协同模式

第五章 2015-2019年中国先进封装技术发展分析

5.1 先进封装技术发展概述

5.1.1 一般微电子封装层级

5.1.2 先进封装影响意义

5.1.3 先进封装发展优势

5.1.4 先进封装技术类型

5.1.5 先进封装技术特点

5.2 中国先进封装技术市场发展现状

5.2.1 先进封装市场规模

5.2.2 龙头企业研发进展

5.2.3 晶圆级封装技术发展

5.3 先进封装技术未来发展空间预测

5.3.1 先进封装前景展望

5.3.2 先进封装发展趋势

5.3.3 先进封装发展战略

第六章 2015-2019年中国芯片封测行业不同类型市场发展分析

6.1 存储芯片封测行业

6.1.1 行业基本介绍

6.1.2 行业发展现状

6.1.3 企业发展优势

6.1.4 项目投产动态

6.2 逻辑芯片封测行业

6.2.1 行业基本介绍

6.2.2 行业发展现状

6.2.3 市场发展潜力

第七章 2015-2019年中国芯片封测行业上游市场发展分析

7.1 2015-2019年封装测试材料市场发展分析

7.1.1 封装材料基本介绍

7.1.2 封装材料市场规模

7.1.3 封装材料发展展望

7.2 2015-2019年封装测试设备市场发展分析

7.2.1 封装测试设备主要类

型7.2.2 全球封测设备市场规模7.2.3 中国封测设备投资状况7.2.4 封装设备促进因素分析7.2.5 封装设备市场发展机遇7.3 2015-2019年中国芯片封测材料及设备所属行业进出口分析7.3.1 塑封树脂7.3.2 自动贴片机7.3.3 塑封机7.3.4 引线键合装置7.3.5 其他装配封装机器及装置7.3.6 测试仪器及装置 第八章 2015-2019年中国芯片封测行业部分区域发展状况分析8.1 深圳市8.1.1 政策环境分析8.1.2 区域发展现状8.1.3 项目落地状况8.2 江西省8.2.1 政策环境分析8.2.2 区域发展现状8.2.3 项目落地状况8.3 苏州市8.3.1 政策环境分析8.3.2 市场规模分析8.3.3 项目落地状况8.4 徐州市8.4.1 政策环境分析8.4.2 区域发展现状8.4.3 项目落地状况8.5 无锡市8.5.1 政策环境分析8.5.2 区域发展现状8.5.3 项目落地状况 第九章 国内外芯片封测行业重点企业经营状况分析9.1 艾马克技术（Amkor Technology, Inc.）9.1.1 企业发展概况9.1.2 企业经营状况分析9.1.3 经营模式分析9.1.4 公司发展战略9.2 日月光半导体制造股份有限公司9.3 京元电子股份有限公司9.4 江苏长电科技股份有限公司9.5 天水华天科技股份有限公司9.6 通富微电子股份有限公司 第十章 中国芯片封测行业的投资分析10.1 芯片封测行业投资背景分析10.1.1 行业投资现状10.1.2 行业投资前景10.1.3 行业投资机会10.2 芯片封测行业投资壁垒10.2.1 技术壁垒10.2.2 资金壁垒10.2.3 生产管理经验壁垒10.2.4 客户壁垒10.2.5 人才壁垒10.2.6 认证壁垒10.3 芯片封测行业投资风险10.3.1 市场竞争风险10.3.2 技术进步风险10.3.3 人才流失风险10.3.4 所得税优惠风险10.4 芯片封测行业投资建议10.4.1 行业投资建议10.4.2 行业竞争策略 第十一章 中国芯片封测产业典型项目投资建设案例深度解析11.1 通信用高密度集成电路及模块封装项目11.1.1 项目基本概述11.1.2 投资价值分析11.1.3 项目建设用地11.1.4 资金需求测算11.1.5 经济效益分析11.2 通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目11.2.1 项目基本概述11.2.2 投资价值分析11.2.3 项目建设用地11.2.4 资金需求测算11.2.5 经济效益分析11.3 南京集成电路先进封测产业基地项目11.3.1 项目基本概述11.3.2 项目实施方式11.3.3 建设内容规划11.3.4 资金需求测算11.3.5 项目投资目的11.4 光电混合集成电路封测生产线建设项目11.4.1 项目基本概述11.4.2 投资价值分析11.4.3 项目实施单位11.4.4 资金需求测算11.4.5 经济效益分析11.5 先进集成电路封装测试扩产项目11.5.1 项目基本概述11.5.2 项目相关产品11.5.3 投资价值分析11.5.4 资金需求测算11.5.5 经济效益分析11.5.6 项目环保情况11.5.7 项目投资风险 第十二章 2022-2028年中国芯片封测行业发展前景及趋势预测分析()12.1 中国芯片封测行业发展前景展望12.1.1 半导体市场前景展望12.1.2 芯片封装行业发展机遇12.1.3 芯片封装领域需求提升12.1.4 终端应用领域的带动12.2 中国芯片封测行业发展趋势分析12.2.1 封测企业发展趋势12.2.2 封装技术发展方向12.2.3 封装技术发展趋势12.2.4 封装行业发展方向12.3 2022-2028年中国芯片封测行业预测分析12.3.1 2022-2028年中国芯片封测行业影响因素分析12.3.2 2022-2028年中国芯片封测行业销售额预测() 图表目录图表 半导体分类结构图图表 半导体分类图图表 半导体分类及应用图图表 半导体产业链示意图图表 半导体上下游产业链图图表 半导体产业转移和产业分工图图表 集成电路产业转移状况图图表 全球主要半导体厂商图表

现代电子封装包含的四个层次图表 根据封装材料分类图表 目前主流市场的两种封装形式图表
2019年全球封测企业市场份额排名图表 2015-2019年日本半导体销售额图表 2019年中国台湾集成电路产值情况图表 2019年中国台湾集成电路产业链各环节产值情况图表 2015-2019年中国台湾集成电路产值图表 2015-2019年韩国半导体产业情况图表 智能制造系统架构图表 智能制造系统层级图表 MES制造执行与反馈流程图表 《中国制造2025》半导体产业政策目标与政策支持图表 2015-2030年IC产业政策目标与发展重点图表 国家集成电路产业投资基金时间计划图表 国家集成电路产业投资基金一期投资分布图表 国家集成电路产业投资基金一期投资项目以及可统计的金额汇总图表 国家集成电路产业投资基金一期投资项目明细：设计领域（不完全统计，下同）图表 国家集成电路产业投资基金一期投资项目明细：封测领域
图表 国家集成电路产业投资基金一期投资项目明细：设备领域

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202201/261588.html>